

# H6120 双组分导热硅凝胶

H6120 导热凝胶是一种双组份室温或加热固化型导热凝胶。主要用于新能源汽车领域,提高电池模组、电源转换及控制系统、车载充电系统等的散热效率,并且具有阻燃、绝缘和填充保护等功能。

## 产品描述

### 固化前参数

条目		A 组份	B 组份	备注
外观		浅绿色膏状	白色膏状	1
粘度	Pa.s	160	160	1
混合比例		1:1		质量比
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.95		GB/T 13354
操作时间	min	60		@25°C

### 产品优点

- 优异的贮藏稳定性;
- 良好的粘附性;
- 优异的可操作性;
- 良好的触变性;
- 低的挥发量;
- 低的比重;
- 良好的阳燃性。

#### 典型运用领域

- 新能源汽车;
- 芯片封装;
- 其他电子设备——用于冷却电子元件,延长使用期,有助于将现场使用的科学仪器和军事设备 保持恒定温度。

## 固化后参数

在推荐的条件下固化:



条目		典型值	备注
硬度	Shore 00	62±1	ASTM D2240
导热系数	w/m.k	2.0±0.05	ASTM D5470
耐压强度	kv/mm	≥10	ASTM D150
体积电阻率	Ω·cm	≥1.0×10 <sup>10</sup>	ASTM D257
连续使用温度	°C	-40 ~ 150	/
阻燃特性		0.15 mmt / V-0 3.0 mmt / V-0	UL94
小分子硅氧烷ΣD3-D10		≤ 70 ppm	/

## 典型的固化性能

## 固化条件

条目	典型值	备注
固化条件	24 小时	@25°C
回化宏计	2 小时	@80°C

以上固化时间仅是推荐的指南。固化条件(时间和温度)应依据客户经验、应用要求、固化设备、 烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

# 使用指南

点胶:配合混合针管,使用点胶机或胶枪即可点胶在需使用位置;桶装组合按照 1:1 比例,将 B组份加入到 A组份中混合均匀,然后再通过点胶/涂抹/印刷等装配方式使用在设计位置;

固化:将组件装备好后室温固化。

## 注意事项

有关本产品的安全注意事项,请查阅安全数据资料。

# 标准包装

- 400ml/罐
- 根据客户要求

## 产品储存

本产品无毒性、无危险性,遵循标准化学品运输和储存。



将产品存贮于未开封的原装容器内,并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

#### 本产品最佳存储条件: 5~25℃, 存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染,请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件 下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息,请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注:本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外,及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题,包括针对某一特殊用途的适用性问题,我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

### 湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路中国长沙智能终端产业园 5 号栋 Tel: +86-731-87827556 www.trumjin.com